# 溶射型ひずみゲージの現場適用 ~溶接型溶射ひずみゲージの検討~

中野 公貴<sup>\*1</sup> 尾﨑 淳一<sup>\*2</sup> Nakano Hiroki Ozaki Junichi

航空機エンジンや火力発電所など高温に襲される設備、機器ではクリープ損傷や疲労損傷などの懸念が あり、ひずみ測定の需要は高い。高温環境下でのひずみ測定では、溶接型ひずみゲージや溶射型ひずみ ゲージなど、特殊なひずみゲージが用いられる場合が多い<sup>(1)(2)</sup>。前者は現場での施工が容易であるが、後 者は設備の整ったラボで施工する必要があり、現場での施工は難しい。本稿では、高温ひずみ測定の有望 な手法の一つとして、溶射型ひずみゲージの現場適用に向けた検討結果を紹介する。

キーワード:高温ひずみ、溶射、フリーフィラメントゲージ、ベースプレート

— 7 —

### 1. はじめに

航空機エンジンや火力発電所のボイラなど、 350℃を超える高温環境において、ひずみを計測 する場合、溶接型ひずみゲージや溶射型ひずみ ゲージなどが利用される。

溶接型ひずみゲージ(図1)はゲージベースやセ ンシング部、ゲージリード部に金属が使用されて おり、完全密閉された構造となっている。この ゲージベースは測定対象の金属面に対して、可搬 式の抵抗スポット溶接機を用いて取付ける。した がって、電源が取れる現場であれば、どこでも容 易に施工することができる。

一方、より可撓性が求められる用途には溶射型 ひずみゲージが用いられる。溶射型ひずみゲージ
(図2)は、フリーフィラメントゲージをセラミック溶射でコーティングしたセンシング部と金属で



図1 溶接型ひずみゲージ



図2 溶射型ひずみゲージ

\*1:計測事業部 計測技術部 福浦グループ 課長

\*2:株式会社 IHI 技術開発本部 基盤技術センター 材料・構造グループ

覆われたゲージリードを使用した構造である。溶 射型ひずみゲージの施工には局所排気設備や、溶 射用ガス供給設備が整った溶射ブース内で測定対 象の金属面に直接溶射施工する必要があり、通 常、現場での施工は困難である<sup>(1)</sup>。しかし小さく 軽量かつ耐熱性、可撓性に優れているため、高温 環境における高速回転体のひずみ測定に適してお り、現場適用が強く望まれている。

本稿では、溶射型ひずみゲージの現場適用のた め、抵抗スポット溶接機で取付けが可能となる金 属製ベースプレートをゲージベースとした現場施 工タイプの「溶接型溶射ひずみゲージ」を試作し、 施工方法の検討を実施した事例を紹介する。

## 2. 溶接型溶射ひずみゲージの試作

一般的な溶射型ひずみゲージの断面構造を図3 に示す。溶射型ひずみゲージは通常の着ひずみ ゲージとは異なりゲージベースが無く、計測対象 の金属母材に対して直接溶射施工する。以下に溶 射施工手順を記す。

①ブラスト処理:測定対象金属表面に対し、接着性および変形追従性を良くするための粗面処理

- ②Ni · Co 系金属のボンド層溶射:溶射ひずみ
   ゲージの接着層施工
- ③酸化アルミニウム(セラミック)絶縁層溶射: フリーフィラメントゲージのベース施工
- ④フリーフィラメントゲージ:ひずみ受感部(グリッド)取付け
- ⑤酸化アルミニウム(セラミック)オーバー コート溶射:フリーフィラメントゲージの固 定とオーバーコート施工

図4に今回試作した溶接型溶射ひずみゲージの 断面構造、図5に施工平面図を示す。ベースプ レートのブラスト処理方法などに違いはあるが、 基本的にはラボ施工の溶射型ひずみゲージの手順 と変わらず、直接の溶射施工対象が計測対象の母 材ではなく金属製ベースプレートになる。使用し たベースプレートの材質は耐熱性の高いインコネ ル 600、板厚は t=0.1mm および 0.2mm の 2 種類と し、ベースプレートの外周には計測対象へ取付け るための抵抗スポット溶接用のスペースを確保し た。ゲージリードにはリード線の電気抵抗および 温度変化を除去する ¢1.0mm の4芯 MI ケーブル を使用し、温度補正用のK型熱電対も併せて溶射 施工した。図6にフリーフィラメントゲージの取



図3 一般的な溶射型ひずみゲージの断面構造



# 図4 溶接型溶射ひずみゲージの断面構造



図5 溶接型溶射ひずみゲージの施工平面図



図6 フリーフィラメントゲージ

付け、**図7**にセラミック溶射後、**図8**に溶接型溶 射ひずみゲージの完成品を示す。

## 3. 静的・繰返し載荷試験

溶接型溶射ひずみゲージについて、静的載荷お よび繰返し載荷試験を行い、ひずみ伝達特性、高 温時の出力特性を確認した。

# 3.1 試験体・試験方法

図9に示す試験片(材質:インコネル 600)の中央 付近に、ベースプレート(幅 8mm × 長さ 14mm、板



図7 セラミック溶射後



図8 溶接型溶射ひずみゲージ(完成品)

厚0.1mmおよび0.2mm)を有する溶接型溶射ひずみ ゲージを配置した(図10)。

この試験体を用いて、室温、300℃、650℃にお ける静的載荷および繰返し載荷試験を実施した。 **表1**に試験条件を示す。

\_ 9 \_



図9 試験体形状(上:ひずみゲージ貼付面、下:側面)



図10 試験体への取付け状態



(a) 室温

表1 試験条件

		静的載荷			繰返し載荷			
試験温度		室温,	300°C,	650°C	室温,	300	°C,	650°C
制御形態		荷重制御			荷重制御			
負荷速度,	波形	手動			0.002	2Hz,	サ・	イン波
繰返し数		1回(室温)または2回			110回			

## 3.2 試験結果

図 11 に静的載荷試験結果を示す。図の縦軸は 試験荷重から算出される応力、横軸は計測された ひずみの値であり、試験材のヤング率を用いて求 めた理論値を併記した。また、室温における試験 では比較のため、一般的なひずみゲージ(箔ゲー ジ)による計測結果も示した。

室温での試験において、箔ゲージによるひずみ 値は理論値と比べて約 10%低い値であったが、除 荷時における傾きは理論値とおおむね一致してい た。一方、溶接型溶射ひずみゲージのひずみ値は 理論値より約 25%低い値であった。このような差



(b) 300°C



図 11 静的載荷試験結果

が生じる理由として、ベースプレートを介して ゲージ部に計測対象のひずみが伝達する複雑な構 造であるため、ひずみが伝達過程で一部損失して いる可能性が挙げられる。

高温時(300℃および650℃)においては、t=0.2mm のベースプレートの応力ひずみ曲線にヒステリシ スが確認された。t=0.1mmのベースプレートの場 合は、ヒステリシスは見られないが、常温時と同 様 300℃では約 19%、650℃では約 14%、理論値 に対して低いひずみ値を示しており、高温でも ベースプレートの影響でひずみの損失が生じてい ると考えられる。

図12に繰返し載荷試験結果を示す。各温度で の lcycle 目と 100cycle 目の結果を比較すると、い













(c) 650°C

図12 繰返し載荷試験結果

ずれの温度条件に対してもドリフトが発生してい る。しかし 100cycle に到達しても得られたひずみ 範囲については安定しており、それぞれのひずみ 範囲(グラフの傾き)は繰返し回数に伴う大きな変 化は見られなかった。

## 4. 溶接型溶射ひずみゲージの適用性について

溶接型溶射ひずみゲージを現場における高温ひ ずみ測定に適用するためには、構造や評価におい て改善の余地がある。具体的には、MIケーブル固 定部のシム板が2重構造かつスポット溶接により 剛性が高くなっていると考えられ、またベースプ レート外周のスポット溶接とゲージグリッドの間 にMIケーブル固定部があるため、ひずみの伝達が 一部損失していると考えられる。以上のことから、 今後ひずみゲージの構造変更を試みる予定であ る。一方、ひずみが理論値より低い値となること、 高温時のドリフトについては、それらの影響を定 量的に評価し、結果を補正する方法を検討する。 一方、繰返し載荷試験においては応力変化に対 して得られるひずみ範囲(傾き)がおおむね安定し ていることから、動ひずみ測定に関しては現場適 用に対して有望である。

#### 5. おわりに

今回試作した溶接型溶射ひずみゲージに対し、 構造や評価方法についての課題を得ることができ た。今後も高温環境下における新たな手法として 研究を行い、計測技術を向上させるとともに現場 適用を目指す。

#### 参考文献

- 三上隆男、松田昌悟:溶射型ひずみゲージによる高温環境下の静ひずみ測定技術、IIC REVIEW、No.51、2014/04、pp.44-50
- (2) 菅原敏博:溶射ゲージによる静ひずみ測定技 術、IIC REVIEW、No.58、2017/10、pp.12-17



計測事業部 計測技術部 福浦グループ 課長 中野公貴 TEL. 045-791-3518 FAX. 045-791-3541

